



紫外激光切割钻孔机

UV Laser Cutting and Drilling Machine



性能特点：

- 高性能紫外激光器：**采用高光束质量、高峰值功率、窄脉宽、高脉冲稳定度的半导体泵浦激光器，它是一种“冷”加工方式，能够保证加工质量和稳定性。
- 优化设计的光学系统：**低功率损耗，较小聚焦光斑尺寸，高的激光光束质量，确保加工精度，并可自动调焦。
- 精密二轴平台和全闭环数控系统：**采用进口高精度直线运动模组和控制模块，从而保证设备高精度的定位精度和重复精度。
- CCD影像定位：**激光加工基准点与设计文件基准点高度重合。
- 天然花岗岩机台：**减小工作台启动、停止和加速过程产生的惯性震动，同时可保持机台温度的稳定性。
- 具有自主知识产权的软件系统：**智能激光微加工应用平台ThetaLaser，是在PowerCAM基础上发展的激光微加工平台，界面友好，功能强大，操作简捷，兼容几乎所有的设计文件格式。
- 款式（选项）：**紫外激光切割机，紫外激光钻孔机，紫外激光切割钻孔机。

THETA 昆山思拓机器有限公司

地址：江苏省昆山市巴城镇红杨路888号
电话：+86-512-50352653/86167186
传真：+86-512-50352629
销售：sales@thetalaser.com
维修：services@thetalaser.com
网址：www.thetalaser.com

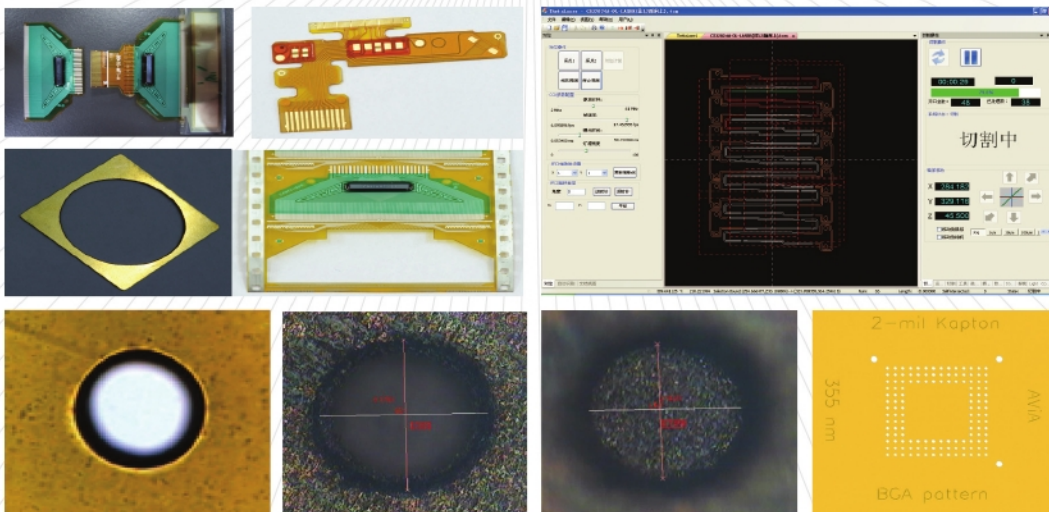
深圳办事处：
地址：广东深圳市宝安区福永街道
富桥第三工业区A4栋
电话：+86-755-81463062/29929570
传真：+86-755-29929557

产品主要应用范围:

- 柔性电路板、刚性电路板、刚-柔结合电路板和芯片封装基板的分板和钻孔加工
- 已安装元件的刚性、柔性电路板的分板加工
- 厚度2.0mm以下的陶瓷精密切割、划片
- 薄铜箔、压感粘接片 (PSA)、PP、丙烯酸片、聚酰亚胺覆盖膜等精密切割及钻孔
- ITO薄膜、玻璃、有机薄膜、特种金属薄片、硅材料、蓝宝石等精密切割
- 支持卷对卷加工方式

技术规格: (3Sigma)

型号	TLS-G8200
加工范围	500mm × 500mm × 50mm (可定制)
X/Y平台定位精度	< ± 3μm
X/Y重复精度	± 1μm
X/Y平台最大运行速度	800mm/s
激光功率	10W(标准配置)
激光波长	355nm
激光频率	30-130KHz
环境温度	23 ± 3°C
环境湿度	20%~70%RH(无凝露)
兼容文件格式	Gerber, DXF, HPGL, Sieb&Meyer, Excellon, PCB
输入电压	三相380VAC ± 10%, 50/60Hz, 15A
电功率消耗	3.0KW
压缩空气气压	0.7~0.8MPa
机器尺寸 (长 × 宽 × 高)	2125mm × 1840mm × 1800mm
机器重量	3500Kg
产地	中国



THETA 昆山思拓机器有限公司

地址: 江苏省昆山市巴城镇红杨路888号
 电话: +86-512-50352653/86167186
 传真: +86-512-50352629
 销售: sales@thetalaser.com
 维修: services@thetalaser.com
 网址: www.thetalaser.com

深圳办事处:
 地址: 广东深圳市宝安区福永街道
 富桥第三工业区A4栋
 电话: +86-755-81463062/29929570
 传真: +86-755-29929557